

2021年3月期 第2四半期（2020年7月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2020年10月29日

内容：

- | | | |
|-----------------|-------------|-------|
| ■ 第2四半期 連結決算の概要 | 取締役 専務執行役員 | 布川 好一 |
| ■ 事業環境および業績予想 | 代表取締役社長・CEO | 河合 利樹 |



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルスの影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。

一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。したがって、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

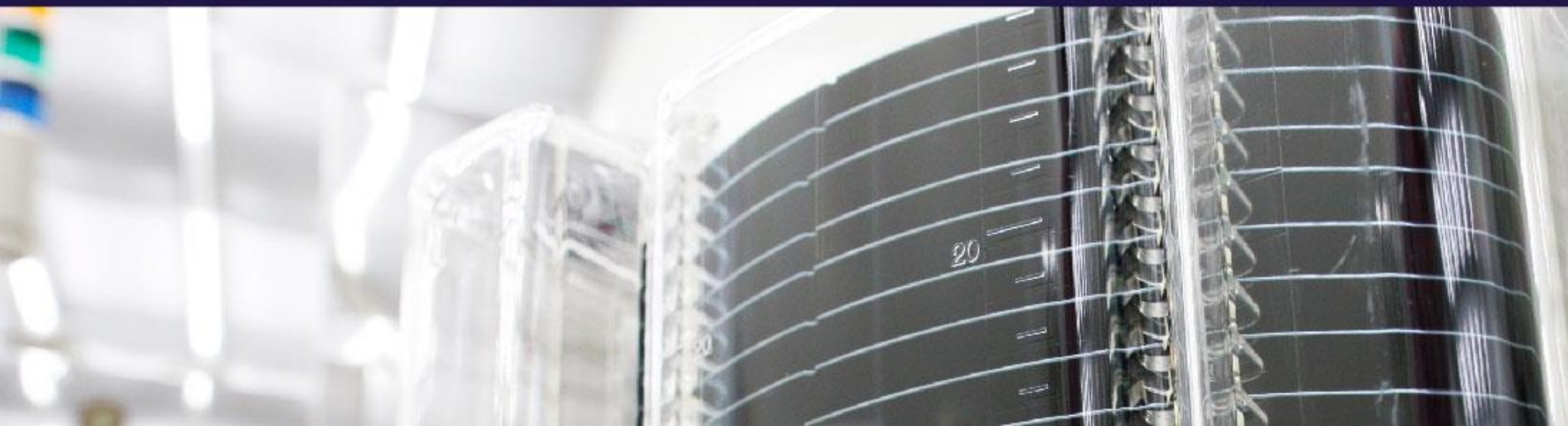
FPD：フラットパネルディスプレイ

第2四半期 連結決算の概要

2020年10月29日

布川 好一

取締役 専務執行役員 Global Business Platform本部長



損益状況（半期）

（億円）

	FY2020		FY2021	対前年H1 増減	（ご参考） 6月18日発表の FY2021 H1予想
	H1	H2	H1		
売上高	5,084	6,188	6,681	+31.4%	6,200
SPE	4,700	5,909	6,354	+35.2%	5,850
FPD	383	277	326	-14.9%	350
売上総利益 下段：売上総利益率	2,045 40.2%	2,474 40.0%	2,648 39.6%	+29.5% -0.6pts	2,480 40.0%
販管費	1,020	1,125	1,173	+15.0%	1,210
営業利益 下段：営業利益率	1,024 20.2%	1,348 21.8%	1,474 22.1%	+43.9% +1.9pts	1,270 20.5%
税金等調整前当期純利益	1,066	1,379	1,477	+38.5%	1,270
親会社株主に帰属する 当期純利益	787	1,064	1,120	+42.3%	950
研究開発費	568	633	663	+16.7%	
設備投資額	296	250	282	-4.9%	
減価償却費	128	162	152	+18.9%	

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

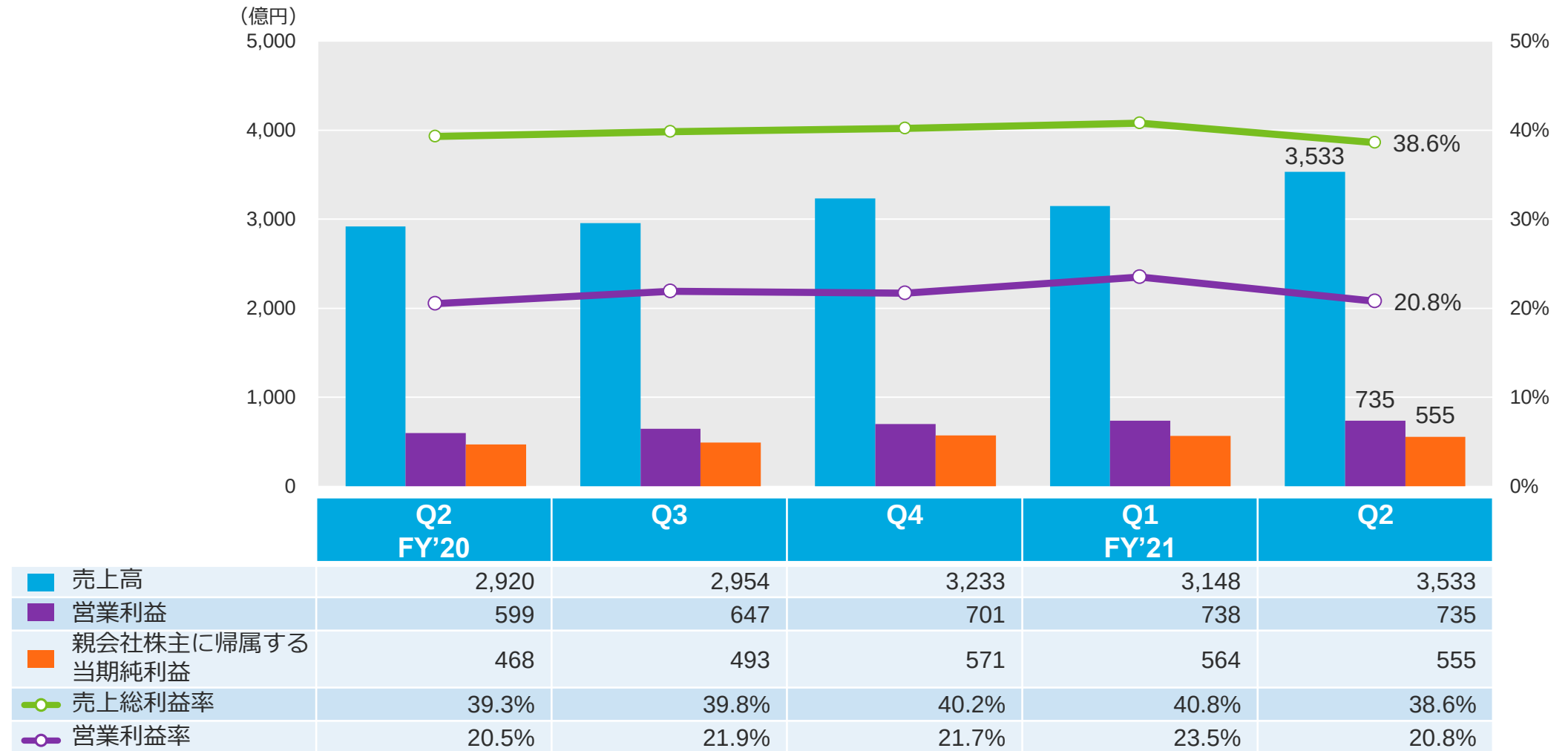
損益状況（四半期）

（億円）

	FY2020			FY2021		対FY2021 Q1 増減
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	
売上高	2,920	2,954	3,233	3,148	3,533	+12.2%
SPE	2,718	2,820	3,089	3,037	3,316	+9.2%
FPD	201	133	143	110	216	+96.3%
売上総利益 下段：売上総利益率	1,146 39.3%	1,175 39.8%	1,298 40.2%	1,284 40.8%	1,363 38.6%	+6.1% -2.2pts
販管費	547	528	597	546	627	+14.8%
営業利益 下段：営業利益率	599 20.5%	647 21.9%	701 21.7%	738 23.5%	735 20.8%	-0.4% -2.7pts
税金等調整前当期純利益	620	646	733	746	730	-2.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益	468	493	571	564	555	-1.6%
研究開発費	312	298	334	301	362	+20.2%
設備投資額	220	132	117	132	149	+12.6%
減価償却費	67	76	86	71	81	+13.3%

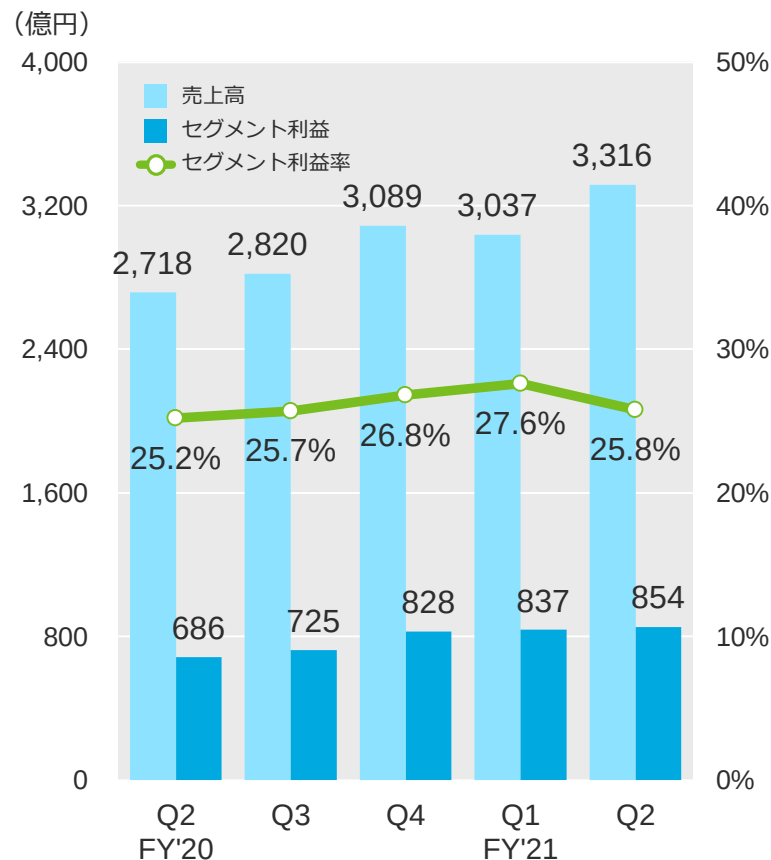
1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況（四半期）

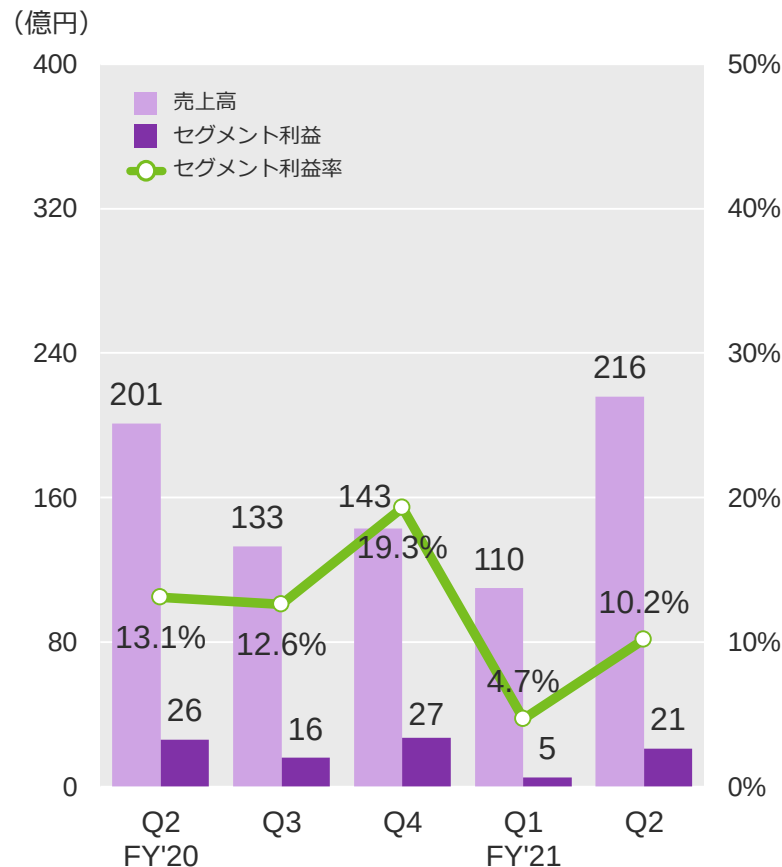


セグメント情報（四半期）

SPE（半導体製造装置）



FPD（フラットパネルディスプレイ製造装置）

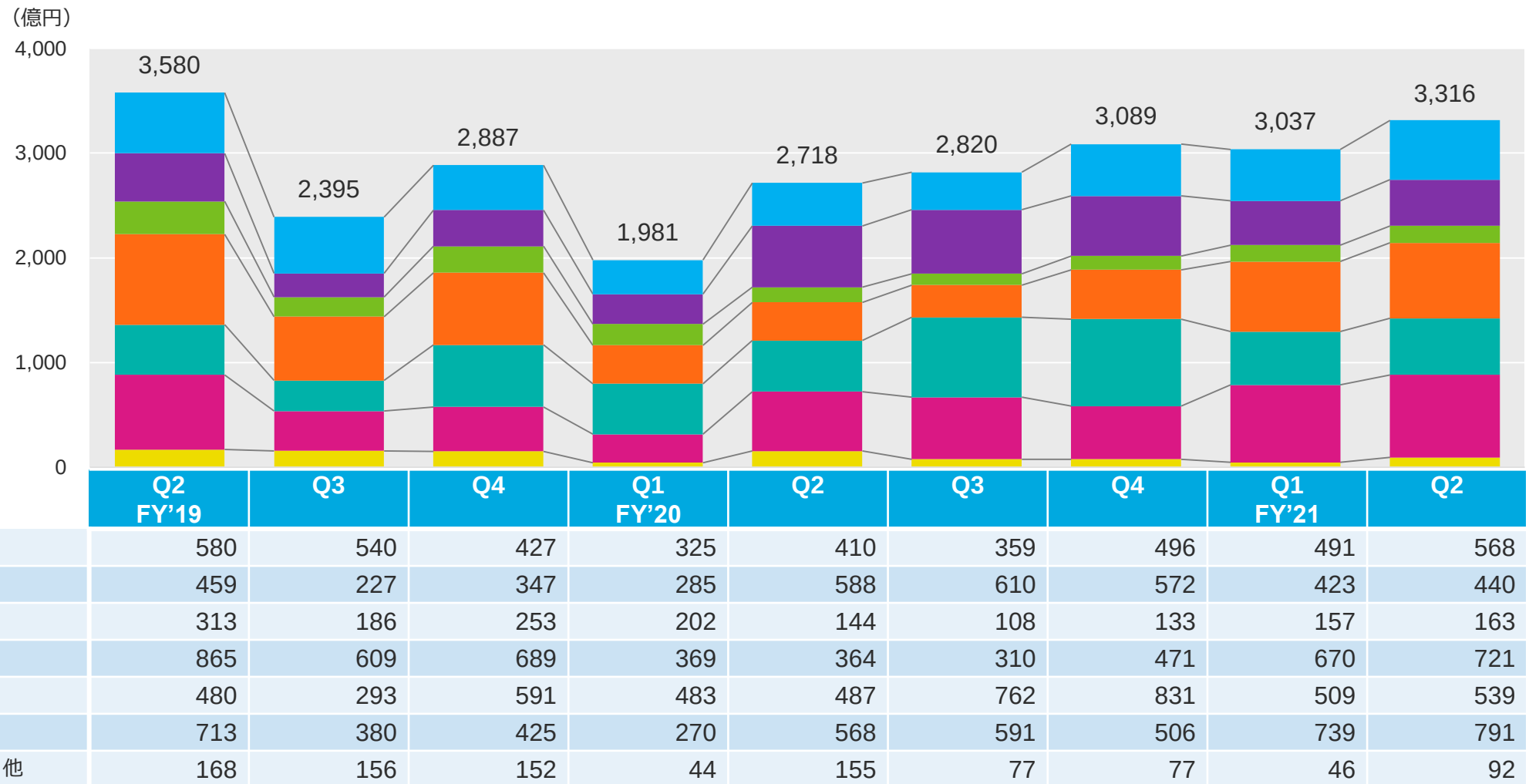


売上構成比率

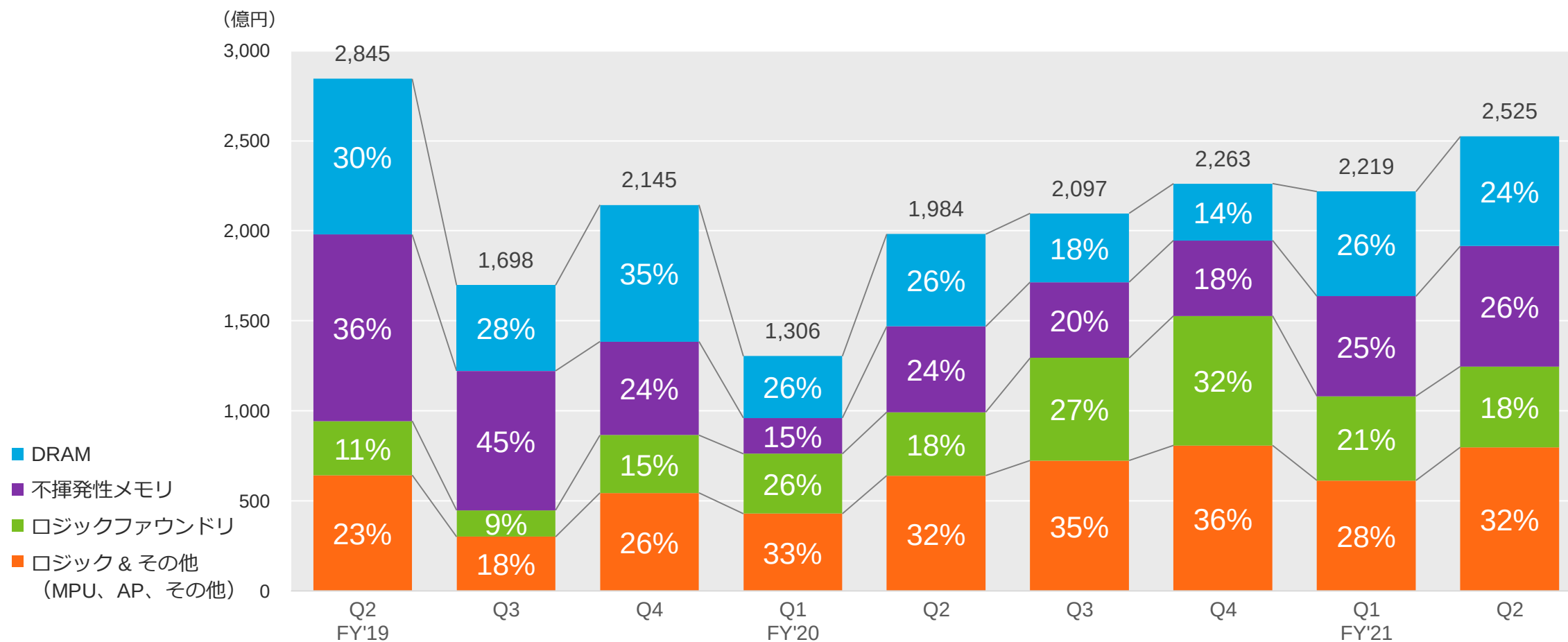


1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究または要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

SPE部門 地域別売上高（四半期）

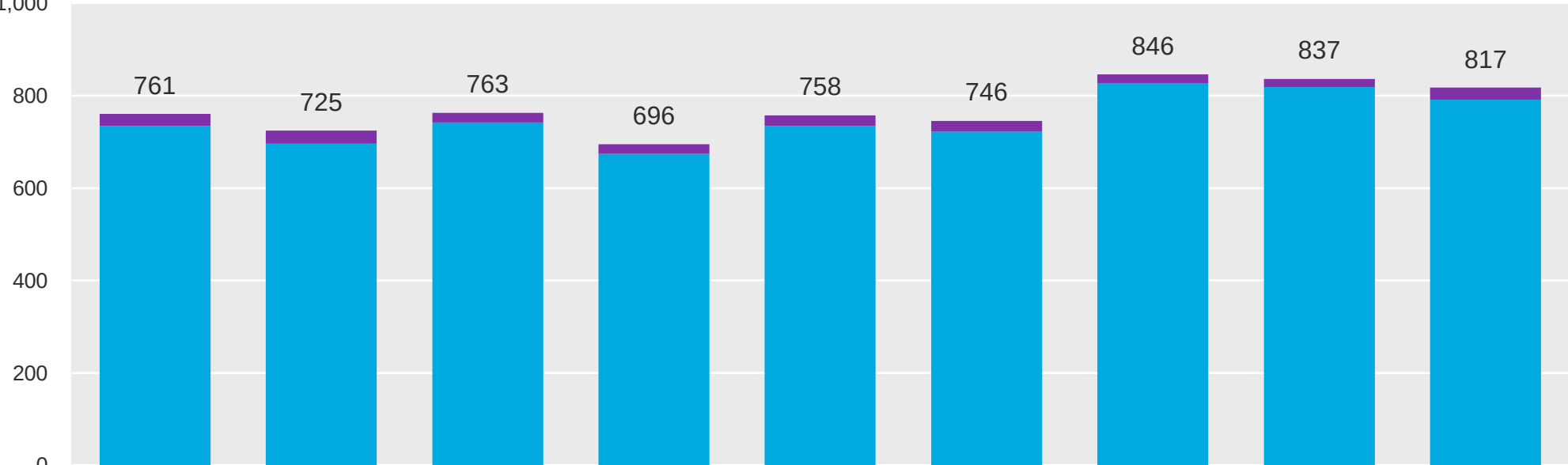


SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



フィールドソリューション売上高（四半期）

(億円)
1,000

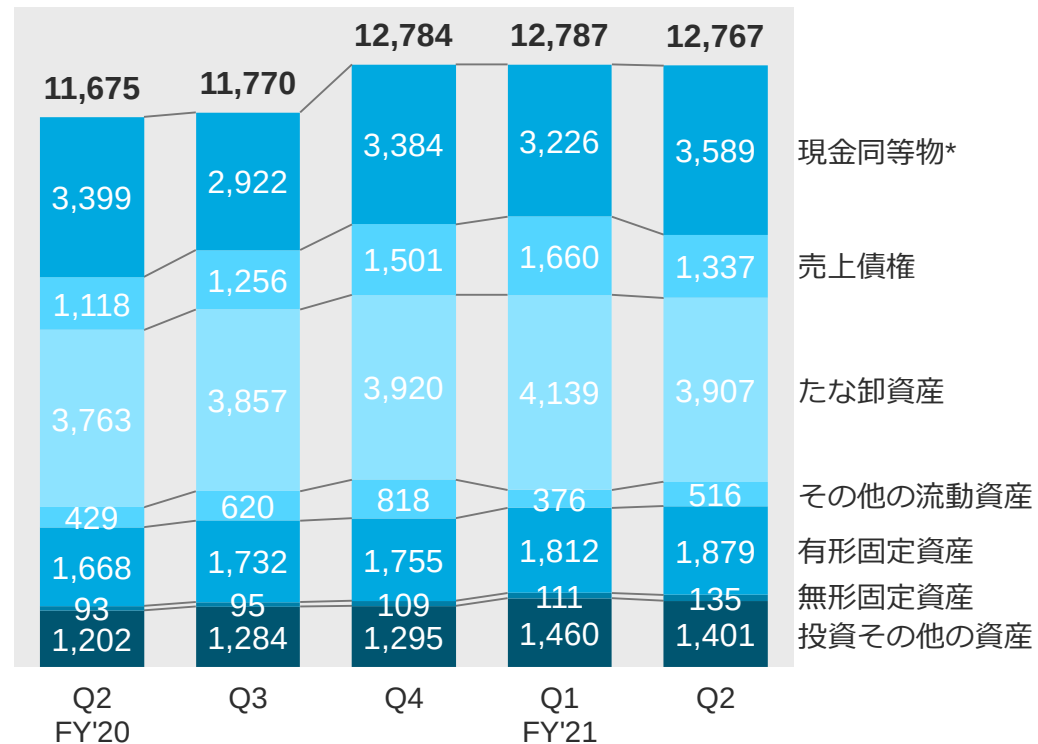


	Q2 FY'19	Q3	Q4	Q1 FY'20	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'21	Q2
SPE売上高	734	696	742	674	734	722	826	818	791
FPD売上高	27	28	21	21	23	23	20	18	26

貸借対照表（四半期）

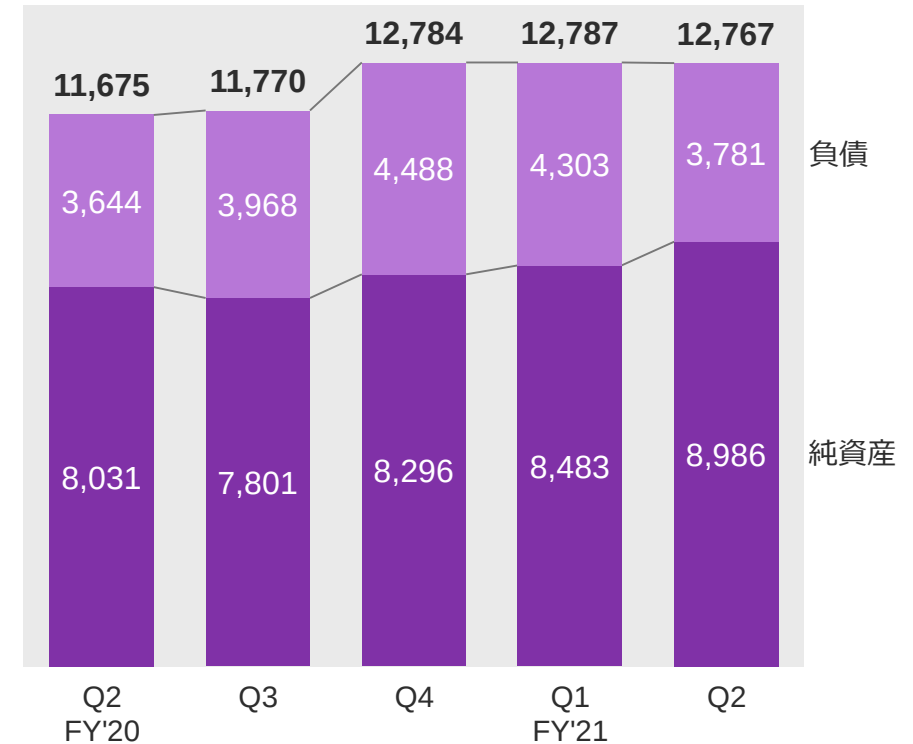
資産

(億円)

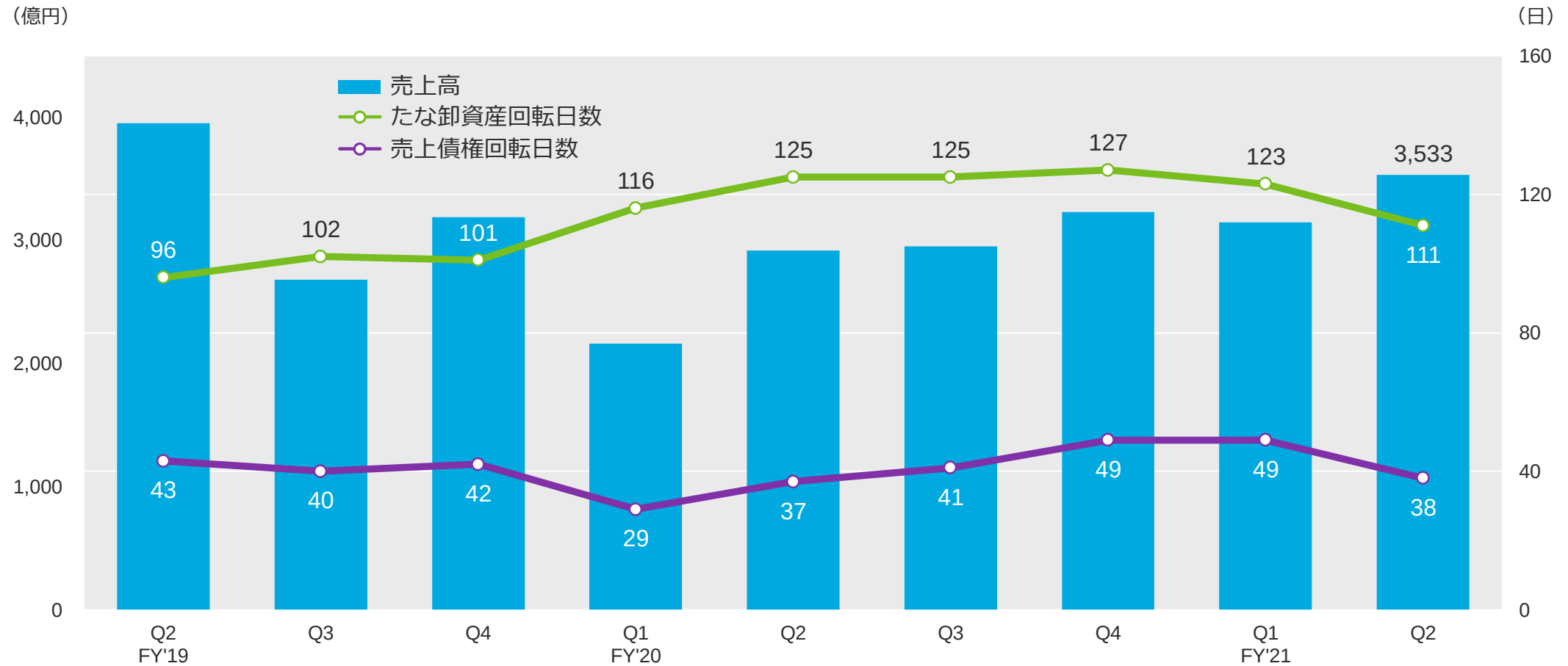


負債・純資産

(億円)

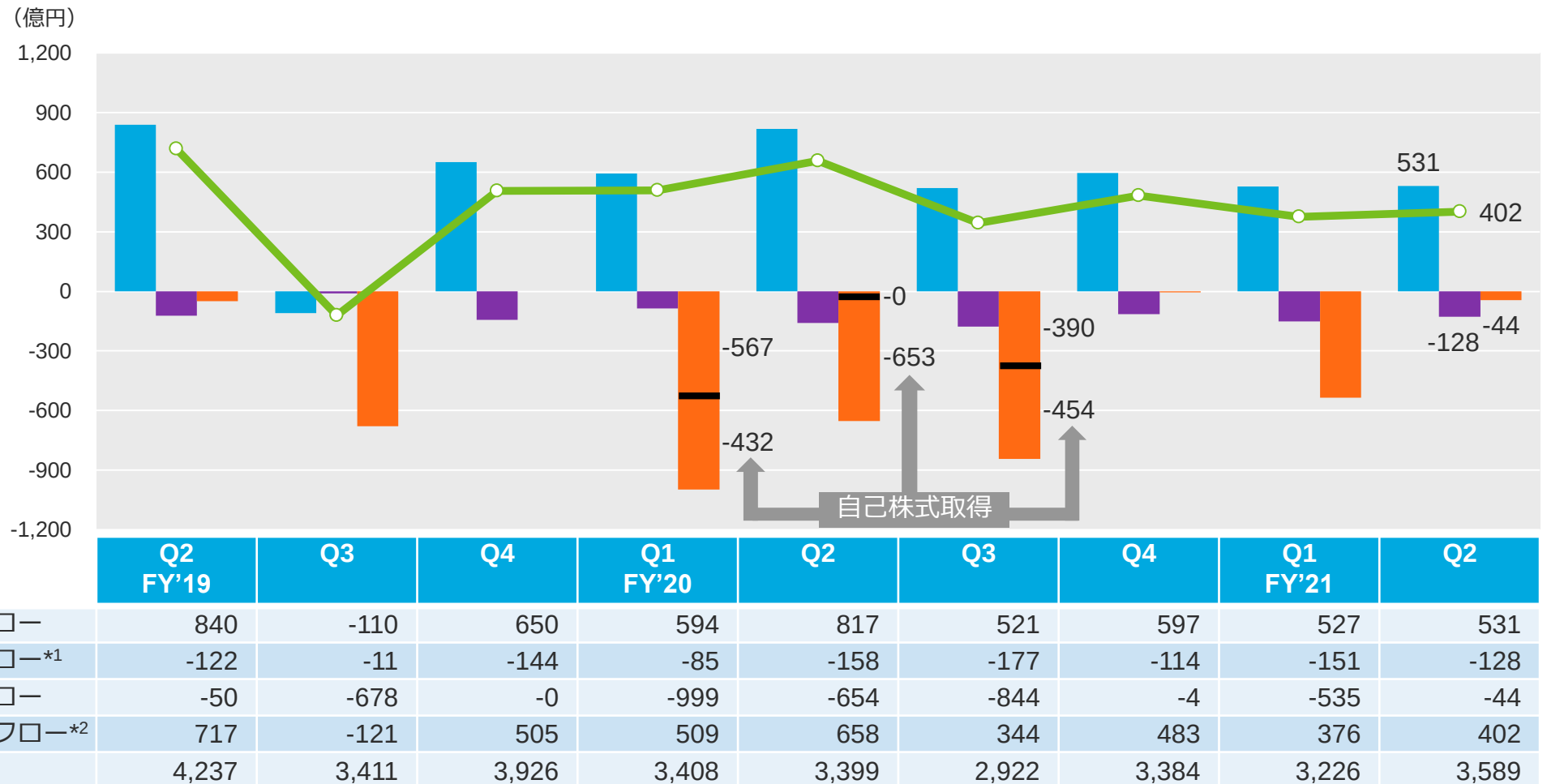


たな卸資産・売上債権の回転日数（四半期）



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー（四半期）



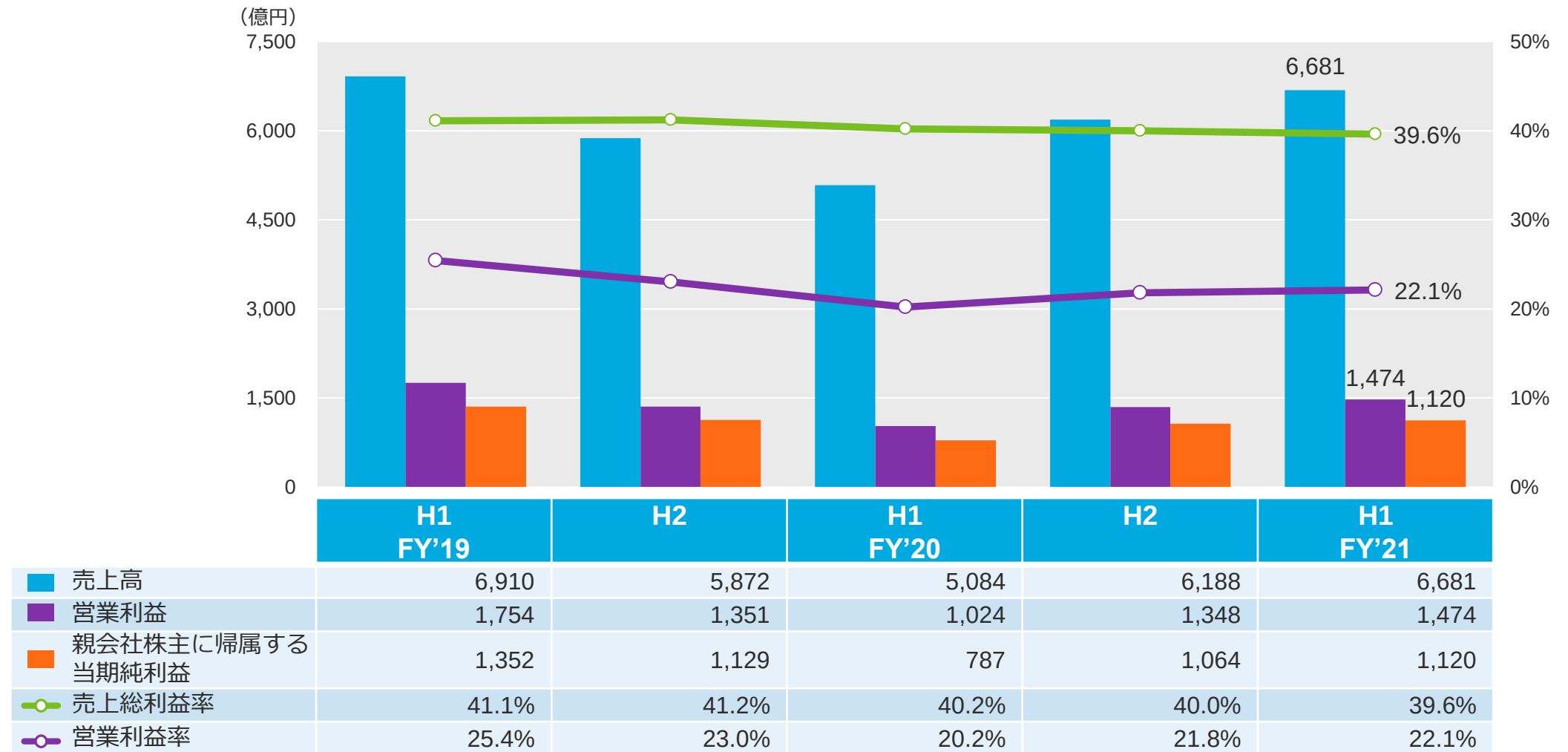
*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

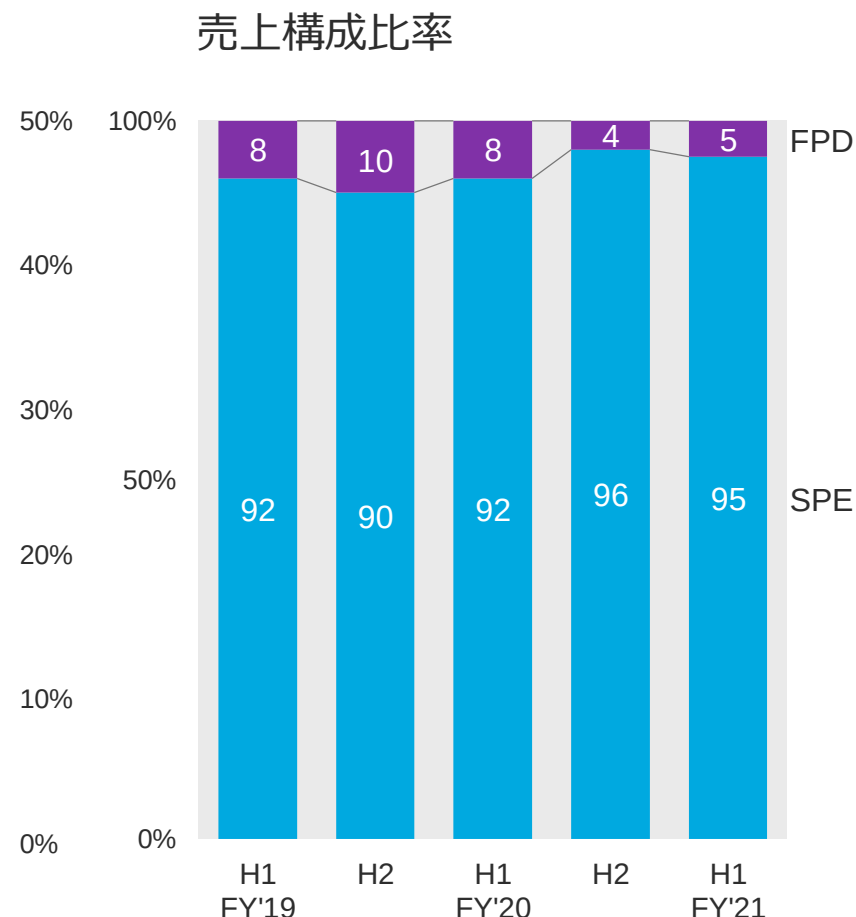
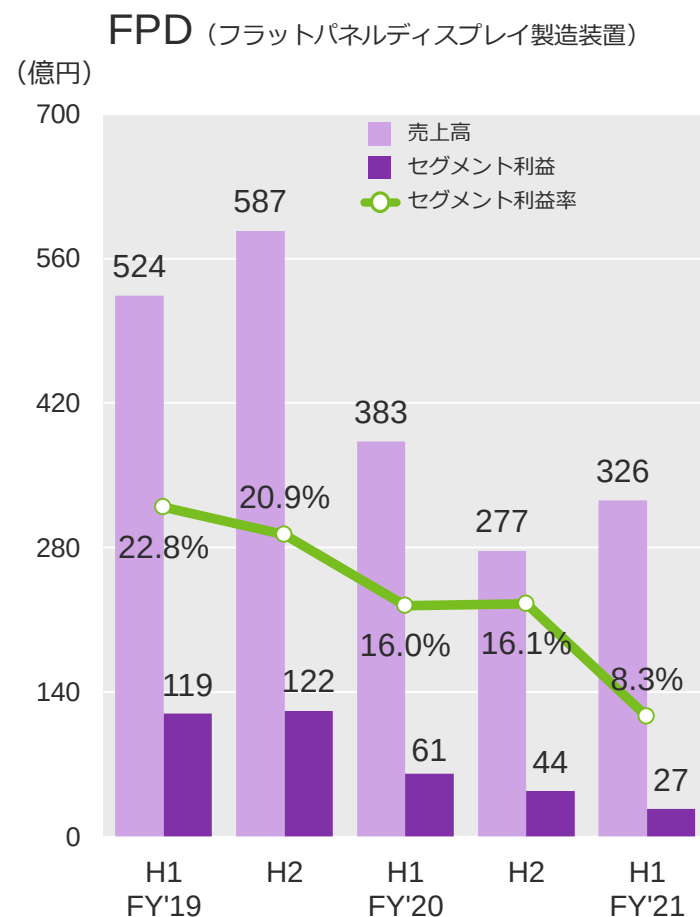
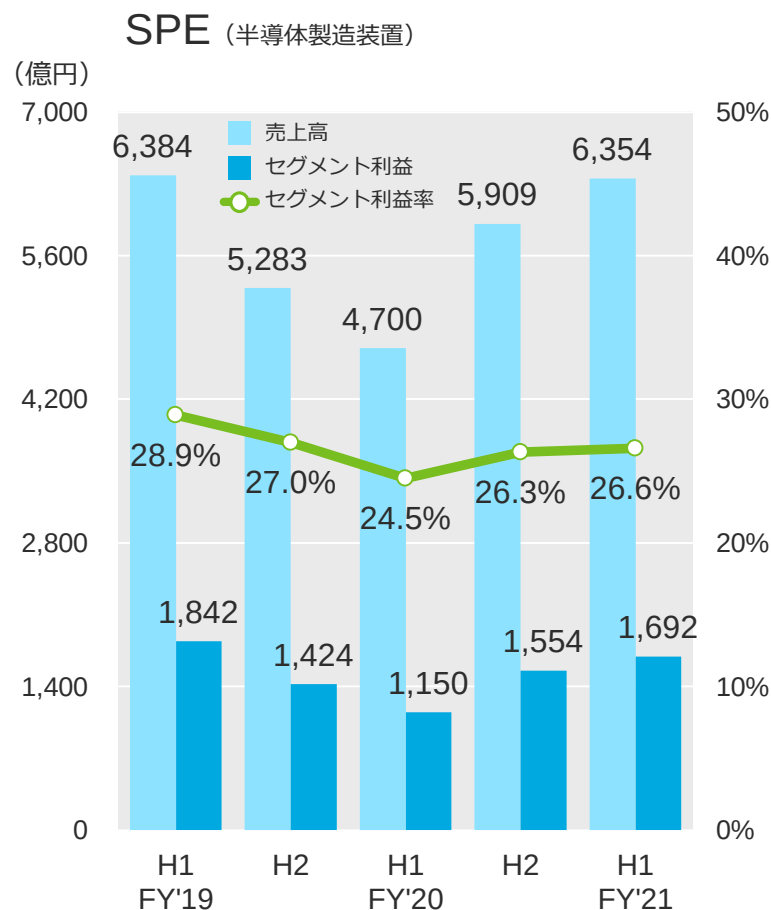
*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

Appendix

損益状況（半期）



セグメント情報（半期）

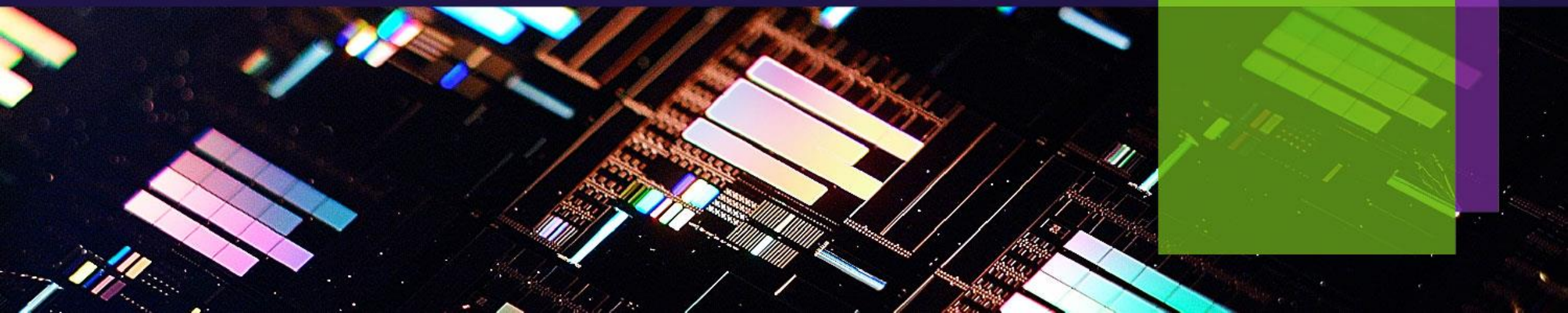


1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究または要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

事業環境および業績予想

2020年10月29日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



CY2020 事業環境（2020年10月時点での見方）

▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*¹の設備投資

CY2020のWFE市場は、前年比10%を超える成長により、過去最高となる見込み

▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*²向け設備投資

TV向け大型パネル投資は継続。モバイル向けOLED投資が回復
CY2020は前年比15%程度の成長を見込む

*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用する製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程

CY2020 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

- ロジック/ファウンドリ：前年を超える高い水準
 - 市場環境： 先端世代、成熟世代ともに需要は堅調
 - 事業機会： 難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大
- DRAM：前年と同水準
 - 市場環境： 設備投資の約8割が1Ynm以降世代向け
 - 事業機会： 微細化に対応した新たな技術の採用
- 不揮発性メモリ：前年比50%程度増加
 - 市場環境： 生産能力の増強投資が加速
9X/12X層数の世代向けが全体投資の8割以上
 - 事業機会： 高付加価値のエッチング・洗浄工程での差別化

FY2021上期 事業進捗

- 上期は売上高、営業利益ともに業績予想を超過。売上高は前年同期比 31.4%の増加、営業利益は同 43.9%の増加
 - 海外への渡航制限がある中、海外現地法人と工場の連携により、装置立ち上げを完遂
 - SPE事業：装置設置の順調な進捗に加え、一部顧客の投資計画の前倒しにより、売上高予想を上回り着地
 - FPD事業：装置設置の活動が進展し、Q2から業績が回復基調
 - フィールドソリューション：顧客工場の高い稼働率と現地在庫量の適正化により、パーツ・サービスの売上が伸張
- 東北工場と山梨工場の両拠点で新生産棟が稼働開始

FY2021 業績予想

FY2021 業績予想修正

(億円)

	FY2020 (実績)	FY2021 (予想)				
		H1	H2	通期		通期 対前年増減
		実績	新予想	新予想	修正額*1	
売上高	11,272	6,681	6,318	13,000	+200	+15.3%
SPE	10,609	6,354	5,845	12,200	+200	+15.0%
FPD	660	326	473	800	0	+21.0%
売上総利益 下段：売上総利益率	4,519 40.1%	2,648 39.6%	2,581 40.9%	5,230 40.2%	+30 -0.4pts	+710 +0.1pts
販管費	2,146	1,173	1,246	2,420	-30	+273
営業利益 下段：営業利益率	2,372 21.0%	1,474 22.1%	1,335 21.1%	2,810 21.6%	+60 +0.1pts	+437 +0.6pts
税金等調整前当期純利益	2,446	1,477	1,332	2,810	+60	+363
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,852	1,120	980	2,100	+50	+247
1株当たり当期純利益 (円)	1,170.57	720.29	-	1,350.57	+32.47	+180.00

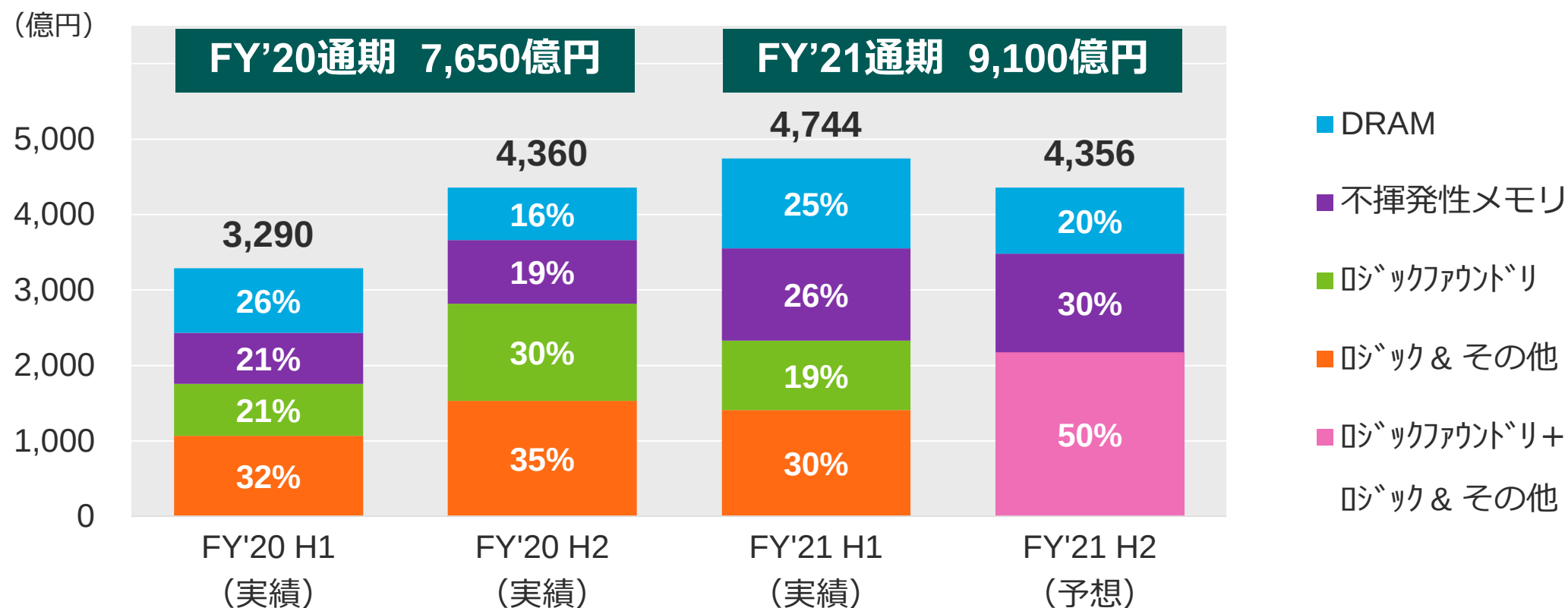
上期の順調な進捗と顧客の追加投資を反映し、通期業績予想を上方修正

*1 修正額：2020年6月18日に発表した業績予想からの修正額を示しています。

SPE：半導体製造装置、FPD：フラットパネルディスプレイ製造装置

FY2021 SPE部門 新規装置売上予想

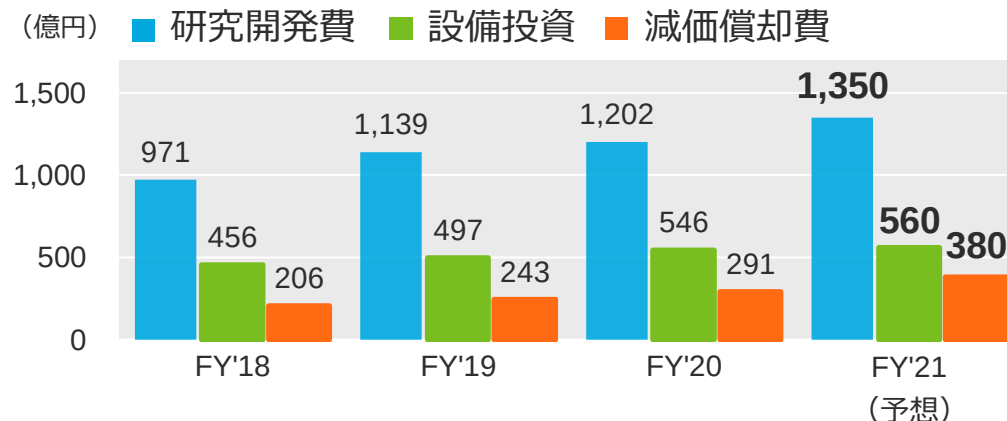
アプリケーション別売上構成比



FY2021新規装置売上高は前年比20%程度の増加を見込む

FY2021 研究開発費・設備投資計画

- 研究開発費 1,350億円
 - － 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 560億円
 - － 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 380億円



新生産棟
(成膜装置・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム)



岩手県奥州市：建設費約130億円
(2020年7月 稼動開始)



山梨県韮崎市：建設費約130億円
(2020年8月 稼動開始)

札幌事業所
(ソフトウェア開発)



北海道札幌市
(2020年11月 開設予定)

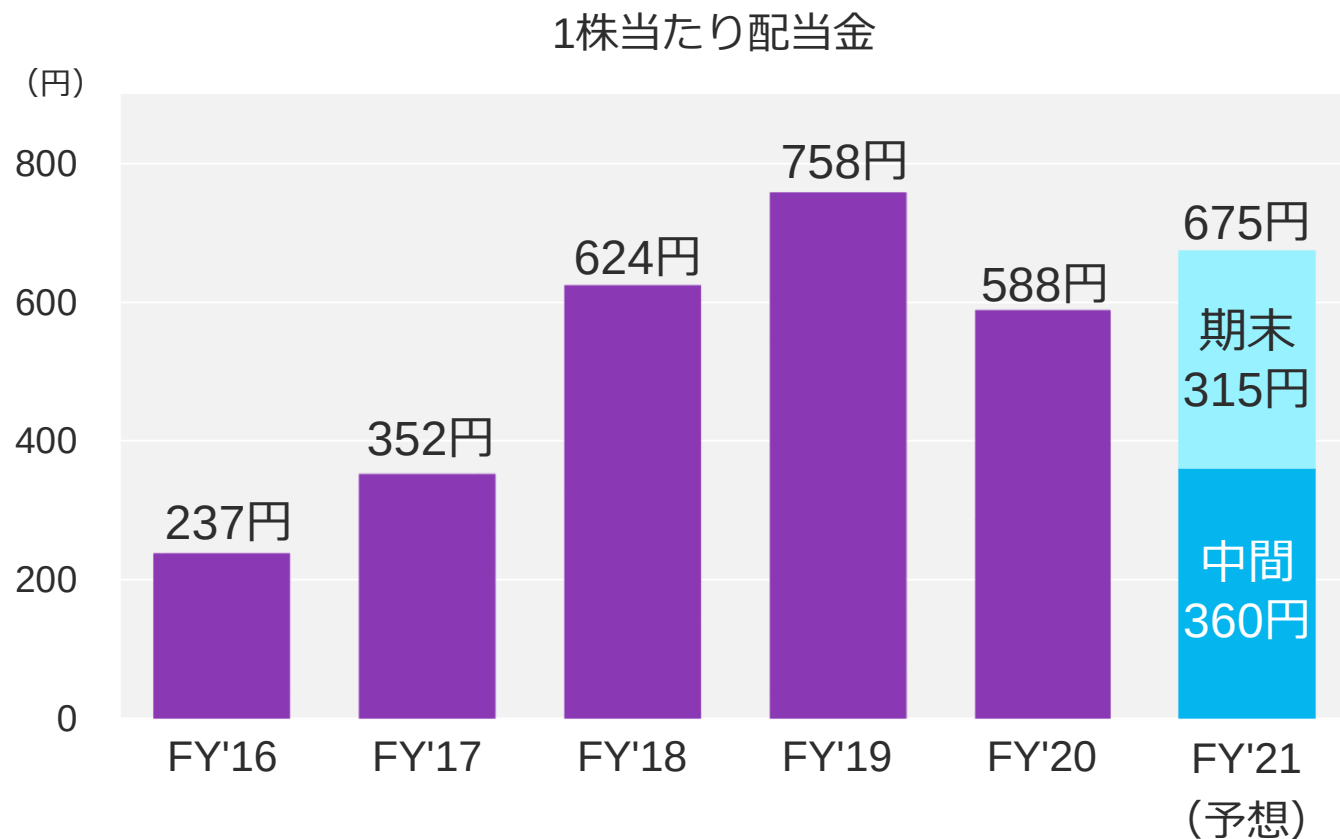
宮城技術革新センター
(エッチング装置)



宮城県黒川郡：建設費約70億円
(2021年9月 竣工予定)

将来の着実な成長を実現するため、過去最高の
研究開発投資および設備投資を見込む

FY2021 配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たり配当金は、配当性向 50%に沿って675円を予定



TOKYO ELECTRON